

$$= k \nabla^2 T + w$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \phi) + \text{div} (\rho \vec{V} \phi - \Gamma \nabla \phi) = S$$

電子機器設計者 **専用** 熱流体解析ソフトウェア

FloTHERM

FloTHERMは世界で最初に開発された電子機器向け熱設計専用の熱流体解析ソフトウェアです。

超高速ソルバー。

例えば100万セルの問題を1時間程度で安定的に計算することができます。

熱設計に特化した機能。

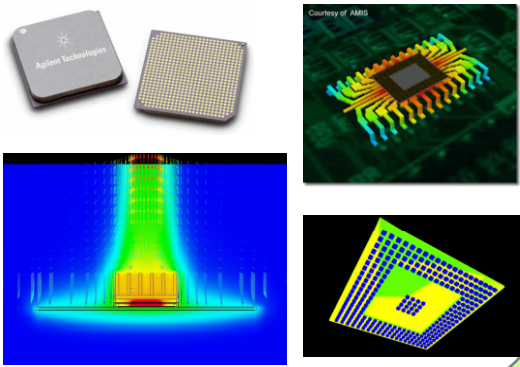
チップ、PCB、ヒートシンク、ファン、穴あき平板など、熱設計専用ソフトウェアならではのユーザーインターフェースと機能があります。

世界初、実績No.1

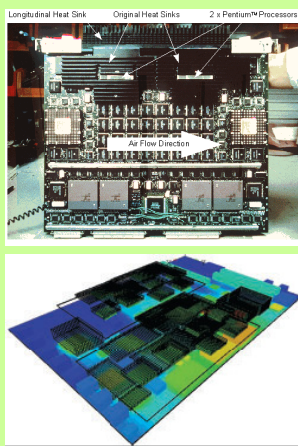
1989年に世界で初めての熱設計専用流体解析ソフトウェアとして開発されました。半導体、コンピュータ、通信機器の主要なメーカーに数多く導入実績があります。

さまざまなレベルの適用事例

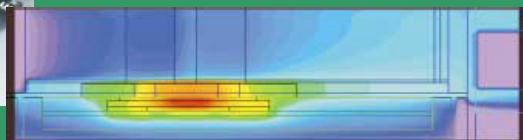
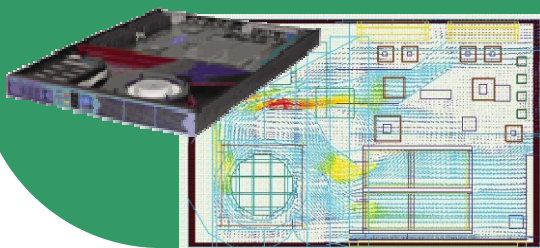
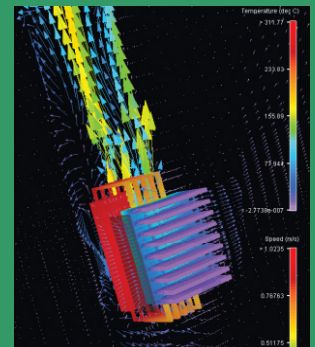
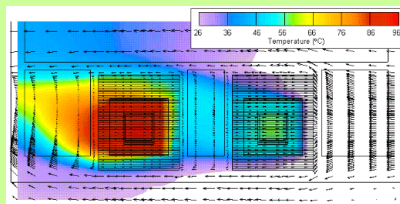
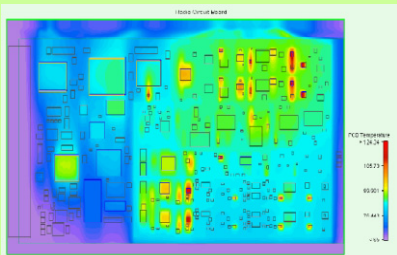
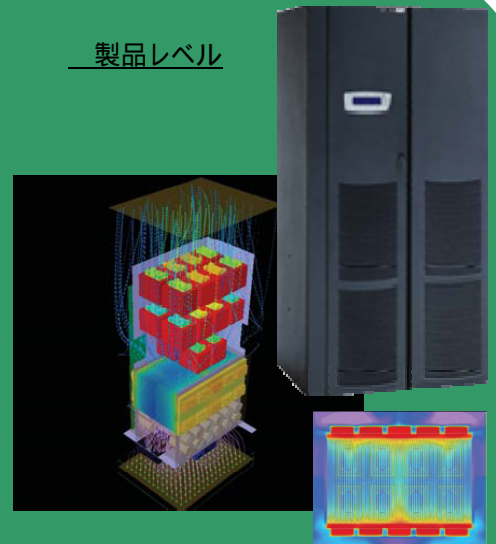
パッケージレベル



ボードレベル

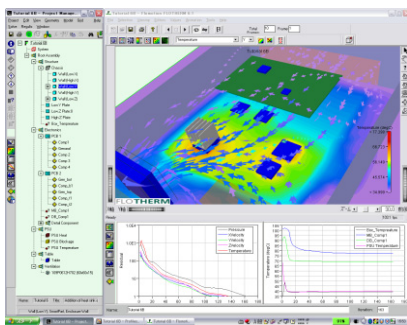


製品レベル



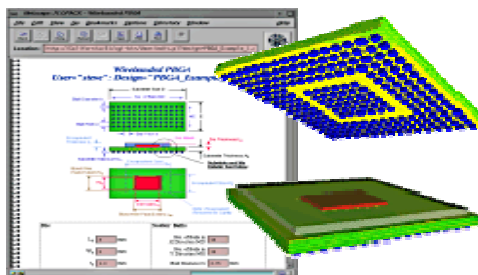
FloTHERM

フレキシブルなインターフェース



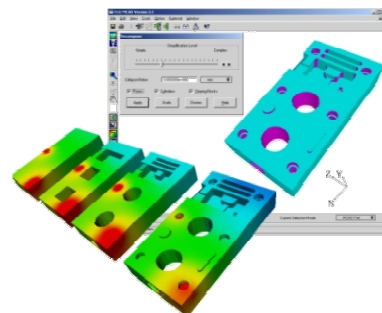
FloTHERMの画面イメージです。モデルデータを構造的に管理するツリー、解析結果の温度コンターおよび速度ベクトルの3次元表示、計測ポイント温度の収束グラフを示しています。マルチウィンドウ形式のため多様な情報をフレキシブルにわかりやすく表示することができます。

日々進化するライブラリ情報



FloTHERM.PACKを利用してパッケージの詳細または簡略モデルを作成し、FloTHERMで温度の解析を行うことができます。例えばBGAの配列パターンを入力することで自動的に詳細モデルが作成できます。Webベースで動作し、日々進化するパッケージ技術に素早く対応します。

3次元CADとの連携



FloMCADを利用することで、3次元CADで作成したSolidWorks、ProE、CATIA、ACIS、STEP、IGES、STL形式の設計モデルを読み込むことができます。読み込んだ詳細モデルは熱設計用に簡略化して解析に利用することができます。

FloTHERM 世界の導入実績

通信	コンピュータ		自動車	航空機	コンシューマ向け	半導体
富士通	富士通	Dell	ホンダ	Airbus	日立	富士通
NEC	NEC	HP	Chrysler	Boeing	コニカミノルタ	AMD
Intel	セイコーエプソン	IBM	Delphi		ソニー	IBM
Motorola	ソニー	Intel	Ford		Philips	Intel
Nokia	東芝	Samsung	PSA Peugeot-Citroen		Samsung	Samsung
Samsung	Apple					

動作環境

OS	Windows 2000 Professional SP3 または SP4 Windows XP Professional SP1 または SP2 Windows Vista
CPU	x86互換のIntelまたはAMDプロセッサ、Pentium 1GHz以上
メモリ	512Mbyte以上 (推奨1Gbyte以上)
グラフィックカード	OpenGLサポート及びメモリ64Mbyte以上

詳細は www.sbd.jp をご覧下さい。

掲載商品および商品名は、各社の商標または登録商標です。
開発元: Mentor Graphics

構造計画研究所 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.

SBD営業部 Email:sbd@kke.co.jp
〒164-0011 東京都中野区中央4-5-3
TEL:03-5342-1051 / FAX:03-5342-1055

<大阪支社>

〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3
NMプラザ 御堂筋ビル5F
TEL:06-6226-1231 / FAX:06-6226-1037

<中部営業所>

〒460-0008 名古屋市中区栄1-3-3朝日会館11階
TEL:052-222-8461 / FAX:052-222-8447

お問合せ